

证券代码：600520

证券简称：三佳科技

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-0602

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 调研：线下 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
来访人	中信建投证券股份有限公司、 富国基金管理有限公司
来访人类型	投资者 <input checked="" type="checkbox"/> 证券机构 <input checked="" type="checkbox"/> 新闻媒体 <input type="checkbox"/> 其他：_____
上市公司接待人员	总经理：昌望 董事会秘书：夏军 证券事务代表：毕静 信息披露专员：王如梦
接待时间	2026年6月2日 10:00时
接待地点	三佳科技党群活动服务中心三楼会议室
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1:请介绍一下公司及主营业务情况。</p> <p>A1:公司成立于2000年4月,公司前身是原电子工业部所属4150、4963、4524三个军工厂,2002年1月在上交所主板上市,被誉为“中华模具第一股”。2025年1月,合肥产投集团旗下合肥市创新科技风险投资有限公司通过股权收购形式成为公司控股股东。公司经过多年发展,目前核心业务涵盖半导体封装装备及智能制造业务两大板块。半导体封装装备具体包括高精度塑封模具、全自动塑封系统与切筋成型设备等;智能制造业务具体包括塑料挤出模具及配套设备、冲压轴承座及配套密封件等。半导体封装装备板块的营业收入占公司主营业务收入约70%,智能制造板块约占30%。</p> <p>Q2:合肥产投集团针对三佳科技未来中长期发展制定了怎样的发展战略?</p> <p>A2:(1)战略定位:将三佳科技打造为集团旗下控股型上市平台,聚焦战略性新兴产业布局,确立内生增长与外延并购相结合的发展战略。</p> <p>(2)为落实发展战略,对公司业务架构和组织架构进行了调整优化,以支撑后续发展。</p> <p>(3)产业整合落地:通过并购整合优质标的众合半导体,提升了上市公司经营规模,依托资源整合破除同行业无序内卷竞争,实现提质增效,夯实上市公司主业基本盘。收购众合半导体既是上市公司内生增长的重要举措,也为后续外延并购、投后整合积累实操经验,对未来收并购的整合具有指导意义。</p>

Q3: 合肥产投集团投资储备项目情况如何?

A3: 合肥产投集团重点围绕集成电路、新能源、新材料等战略性新兴产业及量子、核聚变、低空经济等未来产业进行投资布局, 累计股权投资项目超 500 家。

Q4: 公司与长鑫存储有何关系? 目前是否与长鑫存储有业务往来? 未来是否有合作的空间?

A4: 长鑫存储系我公司间接控股股东合肥产投集团重点孵化投资企业, 穿透后合肥产投集团是其第一大股东。双方团队就相关合作可能性进行过交流, 但截止目前与长鑫存储无业务往来。

Q5: 请介绍公司半导体封装装备的国内市场规模及未来增长预期?

A5: 结合行业发展趋势及市场测算, 预计 2026 年行业将迎来大幅增长, 其中先进封装装备市场规模有望显著提升, 整体行业增长空间广阔。

Q6: 请介绍公司先进封装相关研发团队建设及研发保障情况。

A6: 公司研发聚焦先进封装塑封设备及模具, 保障研发资金投入, 研发团队以研究院为载体独立开展新品研发工作。现阶段先进封装设备研发各项工作有序推进, 研发进度整体符合规划预期。

Q7: 对今年业绩有何展望?

A7: 目前整个行业市场景气度向好, 从一季度的情况来看, 公司在手订单实现明显增长。

Q8: 公司核心产品的交货周期为多久?

A8: 半导体封装系统产品交货周期平均约 90 天, 模具产品交货周期平均约 45 天。通过内部提质增效, 交货周期有缩短空间, 公司产能可有效保障客户需求。

Q9: 公司目前再融资工作进展如何?

A9: 公司将于 2026 年 6 月 15 日召开股东会, 会议主要审议公司再融资相关议案, 后续将依规稳步推进再融资各项工作。

日期: 2026年6月2日